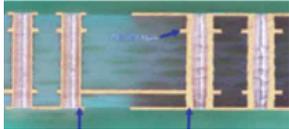
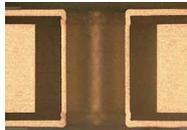
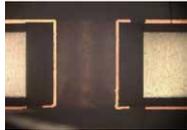
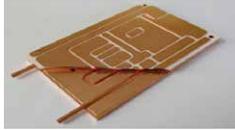


パワー系基板技術ラインナップ

PCB technology lineup for power electronics applications

特長 Features

- 大電流、高放熱、高密度化など多彩な用途に対応した基板技術をご提案。
Large current, high heat dissipation, and high density technologies for various applications.

特長		材料	断面構造
FR-4多層基板 構造を活かした 放熱基板	大電流放熱 小型化 低インダクタンス	メガスルホール	FR-4 
	局所放熱	銅インレイ	FR-4 銅コイン 
	絶縁局所放熱	セラミックインレイ	FR-4 AlNコイン 
発熱部品 メタル直載 高放熱	高放熱	キャビティ構造	FR-4 銅/アルミ 
	高放熱 SMT対応	銅ポスト構造 単層/2層	FR-4 銅 
メタルコア	両面	銅コア 表裏導通	FR-4 銅 
	両面	アルミコア 表裏導通	FR-4 アルミ 
多機能化	液冷構造内蔵	リキッドループ	放熱樹脂 金属ペースト 銅 
	低熱抵抗	ヒートシンク一体	放熱樹脂 金属ペースト Cu/Alヒートシンク 